

杰华特微电子股份有限公司

2023 年度 报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.szse.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，本年度业绩亏损的主要原因请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素(二)业绩大幅下滑或亏损的风险”部分。

Table with 2 columns: 股票代码:688141, 公司简称:杰华特

应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。

Table with 2 columns: 1 公司简介, 2 报告期公司主要业务简介

Table with 2 columns: AC-DC转换器, 主要应用

应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。

Table with 2 columns: 1 主要业务, 2 主要产品

Table with 2 columns: 芯片名称, 主要应用

应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。

Table with 2 columns: 主要业务, 主要产品

Table with 2 columns: 芯片名称, 主要应用

应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。

Table with 2 columns: 主要业务, 主要产品

Table with 2 columns: 芯片名称, 主要应用

应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。

Table with 2 columns: 主要业务, 主要产品

Table with 2 columns: 芯片名称, 主要应用

应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杰华特微电子股份有限公司

2024 第一季度 报告

证券代码:688141 证券简称:杰华特

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

件的最低组合。
BCD工艺是一种单片集成工艺技术，为现阶段模拟集成电路行业的主流工艺。该种技术能够在同一芯片上实现Bipolar、CMOS和DMS器件，结合了Bipolar器件高线性、高增益、高功率、高功耗以及DMS在开关模式下功耗低等优点。因此，整合后的BCD工艺，能够降低模拟芯片的功耗，满足不同模块之间的相互干扰，并降低成本。具体表现如下：
1. 降低功耗：若用二分叉器件进行工作，在系统内部传导过程中会消耗大量能量。BCD工艺能够通过合理的器件组合，有效降低功耗。
2. 减少干扰：BCD工艺具有较高的集成度，避免不同部件间的干扰，改善了系统性能，增强了实际应用的稳定性。
3. 减小尺寸：BCD工艺能够有效降低产品尺寸，因不需要增加额外的工艺步骤，能在总体上减少原材料和封装成本。

资料来源:意法半导体官网、TSMC官网等
现阶段BCD工艺的发展路径是“More Moore”和“More than Moore”齐头并进，即在重视制程的更新外，聚焦高性能化办器器中核芯，使用高耐压工艺方向。目前，BCD工艺的主要应用领域包括电机和电池控制、显示驱动、汽车电子、工业驱动等模拟芯片应用领域，具有广阔的市场前景，并朝着高功率、高频率、高速度三个方向发展。具体表现如下：
1. 高功率：BCD工艺能够实现耐压100-300伏范围的器件，其发展重点在于在制程不断缩小的情况下降低功耗和降低功率器件的功耗。目前“应用电子”和“工业驱动”两大应用领域正在快速发展。
2. 高频率：BCD工艺能够实现中高频应用，如汽车电子、工业驱动等。
3. 高速度：BCD工艺能够实现高速应用，如汽车电子、工业驱动等。
4. 优化功耗和效率：BCD工艺能够实现低功耗应用，如汽车电子、工业驱动等。
5. 减小尺寸：BCD工艺能够实现小型化应用，如汽车电子、工业驱动等。

1. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。
2. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。
3. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。

1. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。
2. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。
3. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。

1. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。
2. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。
3. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。

1. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。
2. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。
3. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。

1. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。
2. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。
3. 应用市场负责旗下应用市场的芯片需求，通过对市场需求进行筛选整理形成产品规格目标书，应用市场定期组织新品立项会，基于新品规格目标书，对产品的开发可行性进行分析评审。评审通过后，该新品研发项目会形成产品立项报告并建档，标志立项工作完成。

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

Table with 2 columns: 项目, 本报告期

杰华特微电子股份有限公司 2024年4月28日